

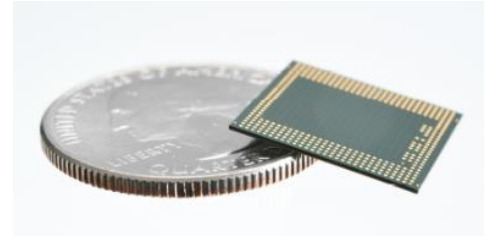
デバイス内蔵パッケージ ～ MCEP[®] ～

MCEP (Molded Core embedded Package : エムセツプ) MCEPは新光電気工業㈱の登録商標です

概要

MCEP[®]は、ICチップや能動・受動部品を内蔵した半導体パッケージです。

新光電気独自の半導体パッケージング技術を駆使し、優れた電気特性と高い信頼性を備えた小型・低背パッケージとして、小型電子機器や各種モジュールに採用されています。

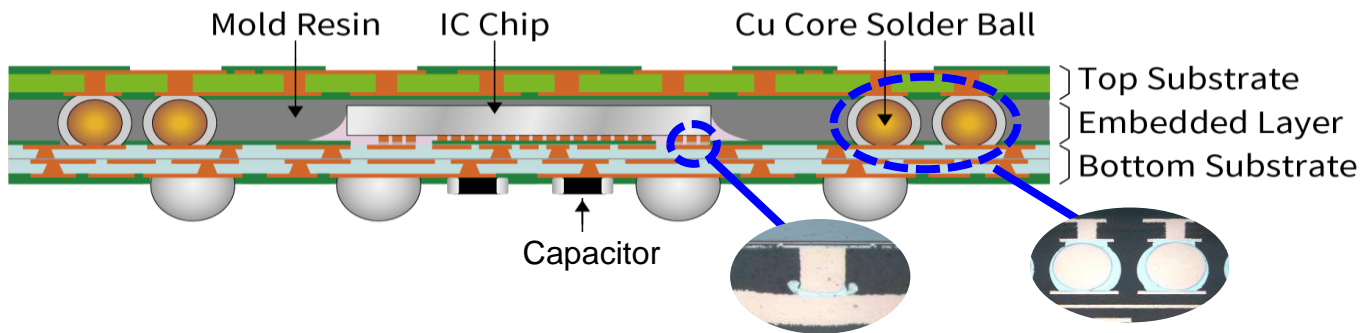


特徴

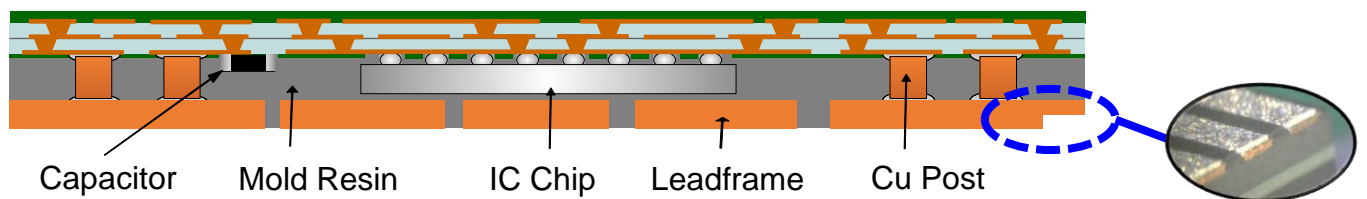
- ・ 組立プロセスのみでICチップや能動・受動部品内蔵を実現
- ・ 小型化・低背かつ低反り化に優れた半導体パッケージ構造
- ・ パッケージ表面のデザインフレキシビリティ
- ・ 高歩留り・高信頼性を裏付ける豊富な量産実績

構造

■ 基本構造



■ 応用例：高放熱モジュール（開発中）



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町80

お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。

<https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php>



SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.

80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN

Please contact us via inquiry form on the web.

<https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php>

